

シールドスインパッキング

Shield thin Packing

STP-07



品番表

Product list

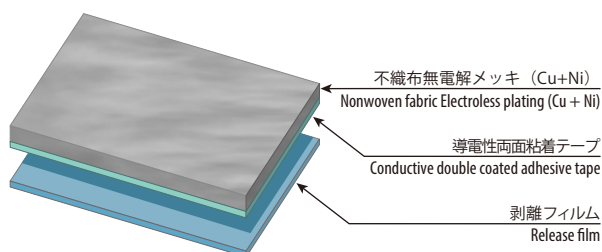
[単位 Unit:mm]

品番 Product code	厚み Thickness	定尺 Fixed sizes
STP-07	0.7±0.2	290×500

※ご希望の形状による切断、打ち抜き、ハーフカット加工品での納入となります。
* Gaskets are cut off, die-cut, or kiss-cut into the desired shape before shipment.

構造

Structure



特長

Features

- ▶ 厚みが薄く、省スペース化が可能です。
- ▶ 優れた導通性がある為、小サイズで使用しても導電損失が少ないです。
- ▶ 任意の形状に切断、打抜き、ハーフカット加工が容易にできます。

Thin thickness and space saving can be achieved.
Due to its high conductivity, conductive loss is low even if it can be used in small sizes.
Gaskets are easily cut off, die-cut, or kiss-cut into various desired shapes.

用途

Applications

- ▶ スマートデバイスのグラウンディング & シールドリング。
- ▶ PDP/LCD の保護及びシールドリング。
- ▶ I/O パネル部のシールドリング。
- ▶ D-sub コネクタ部のシールドリング。

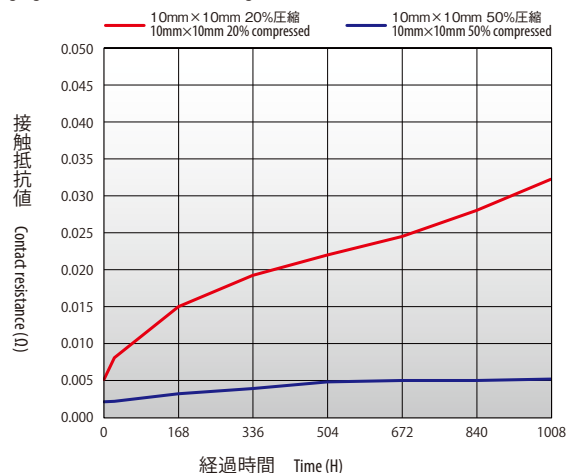
Smart device grounding and shielding.
PDP/LCD protection and shielding.
Shielding of I/O panels.
Shielding of D-sub connectors.

接触抵抗値

Contact resistance

[経時変化特性：70°C放置]

Aging characteristics : 70°C leaving



参考データ

Reference data

No.	項目 Item	測定方法・条件 Test Method and Conditions	試料 Sample	値 Value
1	表面抵抗値 Surface resistance	常温常湿時 normal temperature humidity	10mm□(不織布) 10mm□(nonwoven fabric)	0.1Ω/□以下 0.1Ω/□or less
2	粘着力 Adhesive strength	180°ピール・貼付24時間後 180°Peel test after 24 hours	製品幅 25mm Product Width 25mm	4N/25mm以上 4N/25mm or more
3	圧縮力 Compressive force	0.3mmへ圧縮時の荷重 Load when compressed to 0.3 mm	10mmX10mm	16N

(注) この数値は実測値で保証値ではありません。
* The values are not guaranteed.